

車載向けにテフロン材採用の高周波回路基板の受注開始

当社は、今後拡大が期待される「ミリ波」市場に対応できる高周波基材を用いた基板の開発を進めております。

「ミリ波」とは、30～300GHzの高周波数帯の電波で直進性が高く送信するデータの大容量化が可能で、波長が1～10mmのミリメートルと携帯電話などで使われている電波よりも短く、これらの特徴から屋内広帯域高速無線通信や走行中の車両の速度、車間距離を高精度に検知するセンサ（車載レーダ）への利用で注目されています。更に、イメージング技術への利用ではボディースキャナーや非破壊検査への応用が期待されています。

高周波数帯の電波は伝送時の損失が過大であるため、ミリ波向け高周波回路基板では一般プリント配線板とは異なり損失低減化が必要なため、低誘電率の基材（誘電体）を採用する、あるいは表皮効果（高周波になるほど電流は回路の表層に集中する現象）に対し基板表面の凸凹の影響を抑えるなどが要求されます。

当社は、それら要求に満足しお応えできる製品開発を進めてまいりましたが、その取り組みの一つとして「テフロン材料」を基材に使用した「テフロン2層基板」、更に「テフロン複合基板」の開発を進めております。この「テフロン複合基板」の特長として、高周波特性に優れた基材「テフロン」と一般基材とを複合積層することで、ミリ波向け高周波回路基板の低コスト化、小型化を実現します。

本年8月には両製品ともに試作受注出来る体制が整う予定となりましたのでお知らせいたします。

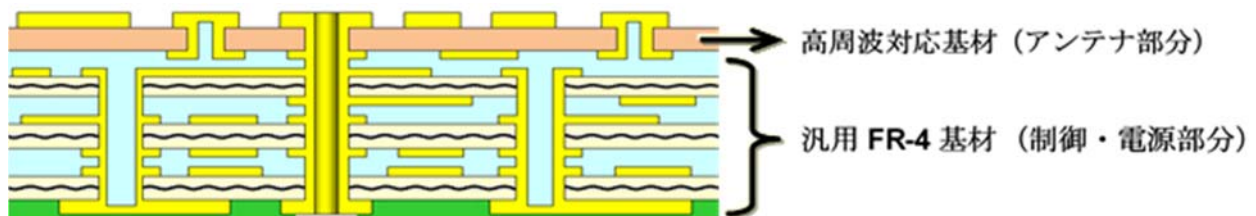
今後は、更に多彩な高周波基材との組み合わせ多様な層構成にも対応出来るようラインナップを準備してまいります。

以上

※「テフロン」は米国デュポン社の登録商標です。

<開発製品内容>

- テフロン2層基板
板厚さ：0.1mm～1.0mm スルーホール径：Min 0.4mm
- テフロン複合基板
板厚さ：0.1mm スルーホール径：Min 0.25mm



<本件に関するお問い合わせ先>

エルナー株式会社
経営企画部 新事業開発グループ
担当：岩波
TEL：045-470-7251